

DDR DIMM



打印日期 2025-12-05

优点

- ForTii® PA4T 在负荷下具备高刚性和高热变形温度 (HDT)，加之其回流焊后的出色低翘曲性及共面度，能够轻松实现可靠性解决方案，性能更优于液晶聚合物 (LCP) 和其他芳香族聚酰胺 (PPA)；ForTii® 使 DDR 制造商能够通过减重减高生产更具成本效益的应用，可在更低或更高的温度实现高可靠性，在服务器中可以有效地减少聚热点,使整个设备热管理效率最优化；ForTii® PA4T 碳足迹较低，并使用不含卤素和红磷的阻燃剂，能够实现可持续的解决方案



细节

ForTii® 使 DDR 制造商能够通过减高减重生产出更具成本效益的应用，可在更低或更高的温度实现高可靠性，在服务器中可以有效地减少聚热点,使整个设备热管理效率最优化

产品

| | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ForTii® Eco E11 PPA-GF30 FR(40) | ForTii® TX1 PPA-GF30 FR(40) | Stanyl® HFX61S PA46-GF35 FR(40) |
| Stanyl® HFX82S PA46-GF45 FR(40) | Stanyl® 46HF5145 PA46-GF43 FR | Stanyl® TE250F8 PA46-GF40 FR(17) |



卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。卖方不做任何其他明示或暗示的陈述或保证。
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。

典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。

版权所有 © Envalior 2025。保留所有权利。未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。